

株主・投資家の皆様へ

LINTEC

WAVE

リンテックウエーブ

*Linking
your
dreams*

DECEMBER 2022

89

● 株主・投資家の皆様へ

代表取締役社長
社長執行役員

服部 真

● スペシャルレポート

リンテックの装置開発

● LINTEC ESSAY

時代を映す鏡「季語」

夏井 いつき

第129期
(2023年3月期)
第2四半期
決算情報

証券コード: 7966

LINTEC WAVE 89

DECEMBER 2022



ながまきこ
中牧湖(長野県)
長野県北部の聖山高原県立公園内にある湖。冬を迎えると霧の水分が周囲のカラマツなどの木々に付着して凍結し、湖畔に真っ白い樹氷が立ち並び幻想的で美しい光景が見られる。

目次

- 2 連結業績推移
- 3 株主・投資家の皆様へ
代表取締役社長 服部 真
社長執行役員
- 4 スペシャルレポート
リンテックの装置開発
- 8 トピックス
- 9 2022年度 新聞広告シリーズ
- 10 LINTEC ESSAY
時代を映す鏡「季語」 夏井 いつき
- 12 アンケート結果のご報告
- 14 決算情報
- 16 セグメント情報
- 19 株式情報

※前連結会計年度において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第2四半期連結累計期間に係る連結経営成績の数値については暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

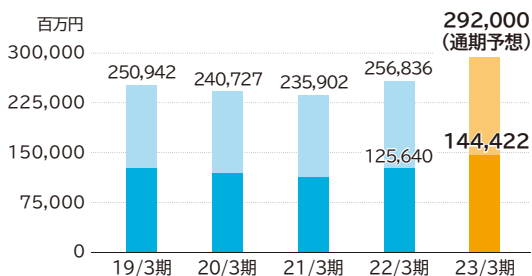
※当第1四半期連結会計期間において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る連結財政状態の数値については暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

(免責事項)

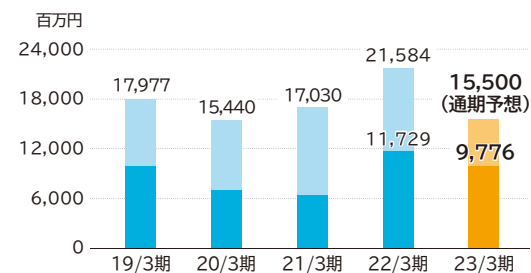
業績予想などの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などはさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

連結業績推移

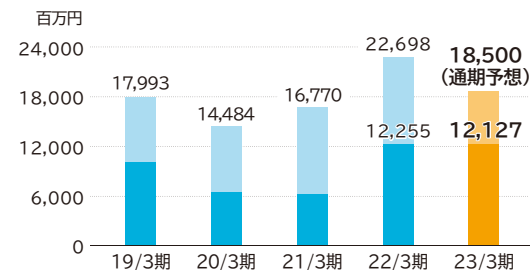
売上高



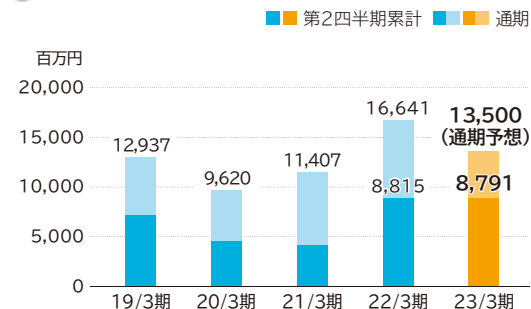
営業利益



経常利益



親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益



▶2023年3月期第2四半期連結累計期間(前年同期比)

売上高

144,422百万円 (14.9%増)

営業利益

9,776百万円 (16.6%減)

経常利益

12,127百万円 (1.0%減)

親会社株主に帰属する四半期純利益

8,791百万円 (0.3%減)

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社グループの2023年3月期第2四半期連結累計期間の業績は、米国グループ会社での買収効果や円安の影響などによって売上高は大幅に増加しましたが、利益面ではパルプをはじめとする原燃料価格や物流コスト上昇の影響を大きく受け、上記のとおり増収減益となりました。

現在、徹底したコスト削減や価格転嫁に取り組んでいますが、第3四半期以降、さらなるコスト上昇に加えて電子・光学関



はっとり まこと
代表取締役社長
社長執行役員 **服部 真**

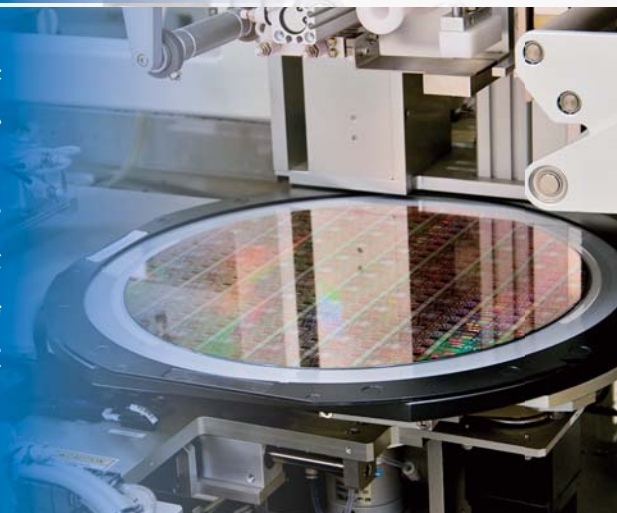
連製品の需要低迷が予想されることから、2023年3月期の通期連結業績予想を以下のとおり修正いたしました。売上高は過去最高となるものの、営業利益は前期実績を60億円下回る見通しです。しかしながら、2016年に買収して以来、営業赤字が続いていたマックタック・アメリカ社が黒字予想となるなど着実に成果も出てきており、引き続き全社一丸となって収益性の改善に努め、業績の向上を目指してまいります。

株主・投資家の皆様には引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

	2023年3月期通期連結業績予想		2022年3月期
	当初予想	修正予想(増減率)	実績
売上高	2,850億円 ▶	2,920億円 (2.5%増)	2,568億36百万円
営業利益	215億円 ▶	155億円 (27.9%減)	215億84百万円
経常利益	215億円 ▶	185億円 (14.0%減)	226億98百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	155億円 ▶	135億円 (12.9%減)	166億41百万円

リンテックの装置開発

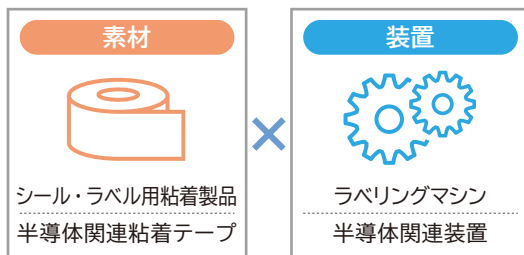
当社グループではシール・ラベル用粘着製品や半導体関連粘着テープだけでなく、それらを貼ったり剥がしたりする関連装置も開発・製造・販売しています。コロナ禍によるインターネット通販市場の拡大やデジタル化の進展などにより、物流センターや半導体の製造現場で使われるこれら装置の市場規模も年々拡大しています。今号では、リンテックの強みでもある装置開発についてご紹介します。



競争力の源泉となる「素材」と「装置」の総合提案力

切手のように水をつけて貼る包装用ガムテープの製造・販売で1927年に創業した当社は、1962年にガムテープで段ボール箱の封函^{ふうかん}などをする各種自動包装機の製造部門を設置し、テープと関連機器を組み合わせた事業展開を開始しました。その後、シール・ラベル用粘着製品が主力製品となってからは、1970年代に対象物にラベルを自動で貼り付けるラベリングマシンや、ラベル用粘着製品に印刷・抜き加工を施すラベル印刷機を開発。さらに1986年には、半導体製造工程で使用するウェハ固定用の特殊粘着テープを開発し、

関連装置と共に提案することで半導体製造工程に革新をもたらしました。このように素材メーカーとしての強みを生かした「素材」と「装置」の総合提案力が、リンテックの競争力の源泉となっています。

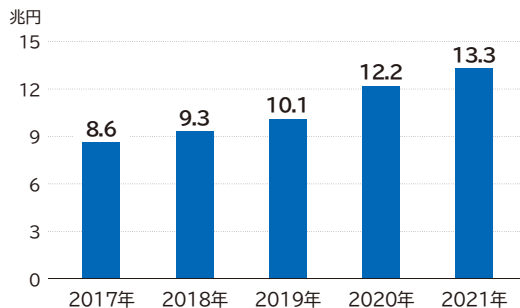


素材と装置を組み合わせた総合提案を展開

物流現場の自動化や省人化ニーズなどに対応するラベリングマシン

当社では宛名ラベルなどを効率良く発行・自動貼りするプリンタ搭載型のラベリングマシンを開発し、「L-VIS II」ブランドとして展開しているほか、顧客ごとのニーズに合わせて自動包装機やコンベヤーなども含む配送システムの提案も行っています。スマートフォンの普及や巣ごもり需要などを背景にインターネット通販市場が拡大しているのに対し、労働力人口の減少によって物流現場や製造現場では慢性的な人手不足が課題となっており、自動化や省人化に寄与する装置へのニーズが高まっています。今後もさらなる需要拡大が予想される中、当社では市場の動向をいち早く捉えた独自の装置開発を進め、ラベル素材とシステムを組み合わせた総合提案力の一層の強化を図っていきます。

国内電子商取引市場規模(物販系分野) 出所:経済産業省



コンベヤーで搬送される荷物にラベリングマシンで宛名ラベルを発行・貼付

PICK UP

省スペース・省電力の新型ラベリングマシン

ラベリングマシンの新機種として、当社は電動モーターで駆動する「L-VIS II ^{イーエル} EL」を開発し、9月より受注を開始しました。一般的にラベリングマシンはラベルを貼付するのにコンプレッサーと呼ばれる空気圧縮機が必要で、設置場所の制約や消費電力などの面で課題がありました。電動駆動によってコンプレッサーが不要な当機種は、小規模スペースにおいてもラベルの自動貼付環境を構築し、消費電力も削減。今後、中小の事業会社を含め、幅広い業界に向けて拡販していきます。

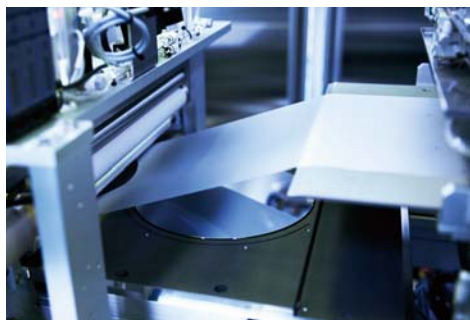
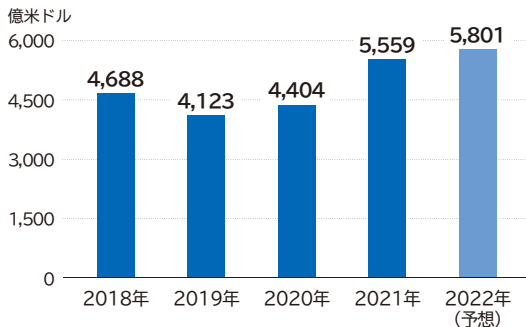


電動化により、配送現場の省スペース・省電力に貢献

テープと装置の総合提案で半導体業界における独自の地位を確立

当社グループでは半導体製造工程の中でも「後工程」と呼ばれるプロセスで使用される高機能粘着テープのほか、それらのテープを貼付・剥離するための装置なども開発・製造・販売しています。世界中に広がる拠点網を駆使して顧客ニーズを迅速に捉え、テープの特性を最大限に生かす装置開発を行うことで、業界における独自の地位を築いてきました。高速通信規格「5G」の普及やAI（人工知能）の需要増加、自動運転技術の進展など社会のデジタル化が進む中、半導体市場は拡大を続けています。足元では一時的な調整局面にあるものの、中長期的にはさらなる成長が予想されており、当社グループでも半導体関連粘着テープ・装置の生産体制の強化を図っています。

世界の半導体市場予測 出所：WSTS(世界半導体市場統計)



半導体の製造工程に不可欠な高品質なテープと装置を提供

PICK UP

世界の半導体製造現場で活躍するリンテックの装置

当社の半導体関連装置は、円盤状のウェハの裏面研削時に表面の回路面を保護するためのテープを貼る装置やそれを剥がす装置、さらにはウェハ切断時にチップが飛び散らないよう固定するためのテープを貼付する装置などが主力製品となっており、世界の半導体メーカー各社に納入しています。近年は生産性向上の観点から、人手を介さずにさまざまな工程を自動化することで、より効率的な生産ラインの構築に寄与する各種装置の開発を推進しています。



テープの貼付や剥離、紫外線照射などのさまざまな機能を搭載したマルチウェハマウンター

FOCUS

伊奈テクノロジーセンター

各種装置の設計・開発から生産までを手がける製造拠点です。不二紙工(株)の自動包装機製造部門を原点とし、1983年に埼玉県の蕨市から現在の所在地である同県の伊奈町に移転。2000年に現拠点名に改称しました。約240人のスタッフが在籍し、新機種の開発および生産能力の向上などに日々努めています。



INTERVIEW

装置需要の動向や今後の開発戦略などについて聞きました。

当社の装置開発における最大の強みは、各種テープやラベル素材の特性を知り尽くしたうえで装置開発ができること。そして国内外に常駐している技術スタッフがお客様の元に足を運び、ご要望や課題をうかがって個別に仕様を最適化した装置を提供できることにあります。コロナ禍を契機とした市場の変化を受け、当社の各種装置の売り上げは好調に推移していますが、その一方では部品の調達難に加え、半導体市場において一時的な在庫調整局面を迎えるなど、市場環境は不透明な状況が続いています。しかし、中長期的には装置需要は底堅いと見ており、今後のさらなる需要拡大を見据えた生産能力の増強が必須になってきます。

私は装置に搭載されるソフトウェアの開発業務に長く携わっていたこともあり、2020年7月に生産管理システムの刷新プロジェクトを立ち上げ、より効率的な生産や部品調達につながるシステムの構築を推進しています。また、技術スタッフの育成強化や増員にも尽力し、特に大きな成長が期待される半導体関連装置においては、2030年までに生産能力を現在の1.5倍以上に高めていく方針です。さらに既存事業の新製品のほか、新規事業に向けた装置開発にも注力していきたいと考えています。



生産本部 伊奈テクノロジーセンター
所長

おのでら くにゆき
小野寺 邦之